# $Fe_{50}Cu_{50}$ 合金熔体相分离过程的分子动力学模拟<sup>\*</sup>

齐玉 曲昌荣 王丽† 方腾

(山东大学(威海)机电与信息工程学院,威海 264209)

(2013年9月12日收到; 2013年11月10日收到修改稿)

基于镶嵌原子势,采用分子动力学模拟的方法探讨了 Fe<sub>50</sub>Cu<sub>50</sub> 合金熔体在 1823 K 下液-液相分离过程. 结果发现:熔体中同类原子配位数随弛豫时间的延长逐渐增大,而异类原子配位数逐渐减少;由 Bhatia-Thornton 结构因子 S<sub>CC</sub>(q) 获得的相关长度随时间的变化也呈现出明显的递增趋势,表明该合金熔体在该温度下发生了液—液相分离.原子轨迹的可视化显示结果发现,相分离的初期,体系呈明显的网络状组织,随时间的延长,异类原子逐渐分离,最终形成富 Fe 和富 Cu 的相分离组织,符合调幅分解特征.与 Fe<sub>75</sub>Cu<sub>25</sub> 合金熔体的相分离过程对比发现,Fe 与 Cu 原子数目相差越小,相分离行为越剧烈,形成稳定分层结构所需的时间越短.以上研究从原子尺度上表征了金属熔体的相分离过程.

关键词: Fe<sub>50</sub>Cu<sub>50</sub> 合金熔体, 液-液相分离, 调幅分解, 分子动力学模拟 PACS: 64.75.Op, 61.20.Ja, 61.25.Mv, 71.15.Pd DOI: 10.7498/aps.63.046401

## 1引言

一些合金在液相区存在不混溶间隙 (miscibility gap), 或亚稳合金在冷却过程中产生液相分离, 我们把在液相中和在冷却过程中产生相分离的合 金均称为液相分离型合金<sup>[1]</sup>. 这类合金在常规凝 固条件下固态组织会由于重力作用而出现分层,使 得其工业应用受到限制. 近年来, 利用电磁悬浮 熔炼法、落管法、雾化法、熔融玻璃净化法和快速淬 火法<sup>[2,3]</sup>等方法均可制备出有特殊结构的相分离 合金. 未来在自润滑轴承材料、电子封装材料、铅 焊球的包裹材料、电子器件材料(如含Ga的合金) 等方向上具有广泛的应用前景<sup>[4-7]</sup>.而相分离型 La-Zr-Cu-Ni-Al 非晶的成功制备也为非晶研究提 供了新的方向<sup>[8]</sup>,发展三维方向具有分层微观结构 的大块金属玻璃,对于理解非晶合金剪切带成核和 传播机制、增强非晶合金的塑性具有重要意义. 且 近年来通过选择性溶解,相分离金属玻璃被应用到 金属多孔材料的设计中<sup>[9]</sup>. 相分离金属玻璃的分离 行为大多数发生在过冷液相区,在较快的冷速下, 高温相在穿越不混溶间隙区时形成的第二相液滴 没有足够时间进行粗化和分层,从而获得相分离组 织. 合金熔体的相分离过程是由两种机制所控制 的: 调幅分解和形核生长<sup>[10-13]</sup>. 前者从自由能的 角度上来说, 是一不稳定过程, 后者则是亚稳过程. 因此调幅分解和形核生长初期动力学过程并不相 同,调幅分解是自发过程,扰动由原始成分开始,最 开始时,由于两相成分在原始成分附近,因此界面 能差非常小,产生网络状组织,界面不明显,由扩散 过程控制;形核则需要先克服一定的能量势垒,使 新的液相从母液中生成长大,成分为最终平衡相, 由于液相之间不存在各向异性,因此新相一般呈球 形,随着扩散的进行,连续长大<sup>[14-16]</sup>.在已有的研 究中,对调幅分解初期和后期的相区尺寸(domain size) 随着时间的变化关系做了很多研究<sup>[17,18]</sup>, 对 有机液体的相分离作用过程也有涉及<sup>[19]</sup>,而对合 金熔体的相分离过程作用机理却鲜有研究,原子尺 度上相分离过程的描述更是未见有所报道.

Fe-Cu合金熔体表现出了明显的相分离特征: 它是典型的包晶型合金,液相线平坦; Fe-Cu合金

\* 国家自然科学基金 (批准号: 51371108) 和山东大学 (威海) 研究生科研创新基金 (批准号: yjs12032) 资助的课题.

© 2014 中国物理学会 Chinese Physical Society

<sup>†</sup>通讯作者. E-mail: wanglihxf@sdu.edu.cn

熔体的混合焓均大于0,间接扩散系数随成分变化 曲线是一条以临界成分点为中心的正抛物线<sup>[20]</sup>. 采用电磁悬浮技术研究过冷态的三元Fe-Co-Cu合 金熔体的结果表明,其在过冷的状态下具有相分离 趋势<sup>[21]</sup>. Wang等<sup>[22]</sup>采用气体雾化方法在Fe-Cu 合金系中获得了心部富Fe、周围富Cu的蛋形结构, 并阐述了这种蛋形结构的形成机制,以及通过控制 材料成分、工艺参数等获得所需形貌的详细信息. 实验中由于Fe-Cu合金熔点高,其熔化过程难以控 制,发生相分离的过程、微观结构变化趋势都很难 通过实验获得.本文采用分子动力学模拟的方法描 述了Fe<sub>50</sub>Cu<sub>50</sub>合金熔体相分离过程,从原子尺度 上揭示了相分离过程熔体结构的演变规律.

## 2 模拟过程

分子动力学 (MD) 模拟使用 XMD 源代码进行 建模和计算, 并用 VC 语言编译程序.本文选用 Bonny<sup>[23]</sup> 作用势,将4000个原子置入周期性边界 条件的立方模拟盒中.其中 Fe, Cu 原子个数比为 1:1.根据 Fe, Cu 晶格常数,将初始的盒子边长定 为 36 Å,原子按照 FCC 结构放置.外界压力设定为 零,恒压过程和恒温过程通过 Andersen 算法实现. 模拟时间步长定为 1 fs.首先体系在 3000 K 温度下 通过等温等压 (NPT) 过程调节,经过 1 ns 的弛豫时 间达到平衡状态,将获得的平衡构型作为下一步相 分离过程计算的初始构型.再把体系温度设置在 1823 K,略高于液相线温度.在恒定温度和压力下 使体系充分弛豫,记录不同弛豫时间下的构型,从 而计算其结构参数来描述液-液相分离过程.

#### 3 结构参数

#### 3.1 配位数

液体的配位数代表给定原子的近邻的平均数. 根据偶分布函数,液体合金 N<sub>ij</sub>(r)的配位数代表在 r距离内α类粒子周围的β类粒子数加上β类粒子 周围的α类粒子数.平均配位数可以用下面的方程 得到:

$$\langle N_{\alpha\beta}(r)\rangle = \rho_{\alpha\beta} \int_0^r g(r) 4\pi r^2 \mathrm{d}r,$$
 (1)

其中 $\rho_{\alpha\beta}$ 为原子数密度, g(r)表示的是以 $\alpha$ 原子 为中心, 在距离r到 $r + \Delta r$ 的球壳范围内发现 $\beta$  原子的概率,也就是偶分布函数(pair correlation function).

#### 3.2 Bhatia-Thornton (B-T)结构因子

B-T 结构因子<sup>[24]</sup> 分别用来描述熔体数密度的 自相关函数  $S_{NN}(q)$ 、数密度和成分波动的相关函数  $S_{NC}(q)$ 以及成分波动自相关函数  $S_{CC}(q)$ .其表达 式如下:

$$S_{\rm NN}(\boldsymbol{q}) = S_{\alpha\alpha}(\boldsymbol{q}) + 2S_{\beta\alpha}(\boldsymbol{q}) + S_{\beta\beta}(\boldsymbol{q}), \qquad (2)$$
$$S_{\rm NC}(\boldsymbol{q}) = C_{\beta}S_{\alpha\alpha}(\boldsymbol{q}) - C_{\alpha}S_{\beta\beta}(\boldsymbol{q}) + (C_{\beta} - C_{\alpha})S_{\alpha\beta}(\boldsymbol{q}), \qquad (3)$$

$$S_{\rm CC}(\boldsymbol{q}) = C_{\beta}^2 S_{\alpha\alpha}(\boldsymbol{q}) + C_{\alpha}^2 S_{\beta\beta}(\boldsymbol{q}) - 2C_{\alpha}C_{\beta}S_{\alpha\beta}(\boldsymbol{q}), \qquad (4)$$

这里q表示散射矢量;  $C_{\alpha}$ ,  $C_{\beta}$ 分别代表 $\alpha$ ,  $\beta$  ( $\alpha$ ,  $\beta$  = Fe, Cu)两类原子占粒子总数的百分比,  $S_{\alpha\alpha}(q)$ ,  $S_{\alpha\beta}(q)$ ,  $S_{\beta\beta}(q)$ 分别代表二元合金 $\alpha$ - $\beta$ ( $\alpha$ ,  $\beta$  = Fe, Cu)的三种偏Faber-Ziman (F-Z)结构 因子<sup>[25]</sup>.  $S_{CC}(q)$ 的值反映了液体的浓度波动,当  $q \rightarrow 0$ 时, 如果 $S_{CC}(q)$ 的值突然增大, 说明液体具 有相分离的趋势<sup>[26]</sup>. 相反, 如果 $S_{CC}(q)$ 值无明显 增大趋势, 表明液体成分较为均匀, 无相分离现象 出现.

#### 3.3 相关长度

相关长度反映合金熔体成分波动程度, 定义 如下:

$$\xi = \xi_0 \varepsilon^{-v},\tag{5}$$

其中,  $\varepsilon = \frac{T - T_c}{T_c}$ , T为温度,  $T_c$ 为临界温度.  $\xi_0$ 是振幅常数, v是临界指数.  $S_{CC}(q)$ 与相关长度  $\xi$ 存在如下关系<sup>[27]</sup>:

$$S_{\rm CC}(\boldsymbol{q}) = K_{\rm B}T_x / [1 + q^2 \xi^2 + \cdots],$$
 (6)

其中,  $K_{\rm B}$ 代表 Boltzmann 常数,  $T_x$ 代表温度. 假定 $A = \frac{1}{K_{\rm B}T_x}, B = \frac{\xi^2}{K_{\rm B}T_x}, 则 \frac{1}{S_{\rm CC}(q)} = A + Bq^2,$  $\xi = \sqrt{\frac{B}{A}},$ 从而获得合金熔体的相关长度.

4 结果与讨论

#### 4.1 Fe<sub>50</sub>Cu<sub>50</sub>合金熔体相分离过程可视化

Fe<sub>50</sub>Cu<sub>50</sub>合金熔体在温度为1823 K其液-液 相分离过程如图1所示.图1(a)代表Fe<sub>50</sub>Cu<sub>50</sub>合 金熔体在3000 K温度下0时刻的原子位置.可以 看出,Fe原子和Cu原子近似均匀分布在熔体中. Fe-Fe原子对、Cu-Cu原子对有所偏聚,但并不十分 明显.Fe<sub>50</sub>Cu<sub>50</sub>合金的熔点约为1750 K,模拟所选 择的温度略高于熔点.图1(b)表明即使是在液相 线以上的温度,Fe<sub>50</sub>Cu<sub>50</sub>合金熔体依旧发生了液-液相分离.具体表现为:随时间延长,异种原子对 逐渐分离,同种原子对相互聚集.在扩散的初期, 形成了网络状组织,浅色的Cu原子形成网格,将 深色的Fe原子包围,符合调幅分解特征.相变初 期,扰动由原始成分开始,由于两相成分在原始成 分附近,因此界面能差非常小,所以产生网络状组 织,又由于时间较短,原子的扩散尺度仅局限在较 小范围.但随着时间的延长,同类原子相关联尺度 进一步增大,网络状组织迅速被打破,如图1(d)所 示.之后,形成较小尺度的Cu原子簇逐渐向较大 尺寸的Cu原子簇聚集;同样较小尺寸的Fe原子簇 也逐渐向较大尺寸的Fe原子簇扩散,使得同类原 子相互聚集,最终形成富Fe层和富Cu层的微观结 构,如图1(i)所示.

在1823 K的温度下,对比2 ns 和3 ns 时,原子间的相对位置几乎不再变化,到达了平衡的状态,在平衡状态下 Fe<sub>50</sub>Cu<sub>50</sub> 合金熔体有明显的分层.



图 1 Fe<sub>50</sub>Cu<sub>50</sub> 合金熔体在 1823 K下的原子轨迹 (a)—(j) 表示的是时刻 0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1, 2, 3 ns; 深色球是 Fe 原子, 浅色球是 Cu 原子

作为对比,我们也模拟了1823 K温度下 Fe75Cu25合金熔体的原子运动轨迹,如图2所示. 由于Fe和Cu原子比例为3:1,我们把Fe原子作 为溶剂, Cu原子作为溶质. 图2(a)表示的是在 3000 K下经过1000 ps的结构弛豫获得的构型图, Cu原子零散地分布在Fe原子中,并没有非常明显 的聚集.随着时间的延长,在相分离的初期,并没有 像Fe50Cu50合金熔体那样形成明显的网络状组织, 而是Cu原子之间不断聚集,通过长距离的扩散, 最终形成一定尺寸的富Cu小液滴,如图2(i)所示. 三个富Cu小液滴随时间的进一步延长并没有停止 扩散,而是继续相互聚集,最终形成一个大的液滴 分布在Fe基体中,如图2(j)所示.对比Fe<sub>50</sub>Cu<sub>50</sub>, Fe75Cu25两种合金熔体原子轨迹可视化图形,可以 看出两种合金熔体在相分离的初期均受调幅分解 机制控制. 只是在Fe75Cu25合金熔体中不是十分 明显,形核生长机制在其随后的弛豫过程发挥主导

作用,体系最终形成了一定尺寸的富Cu液滴分布 在Fe基体中;而Fe<sub>50</sub>Cu<sub>50</sub>合金熔体的调幅分解十 分明显,网络状的组织形成后被迅速打破,最终形 成富Fe层及富Cu层.这与Sohn等<sup>[9]</sup>提到的相分 离机理和成分之间的关系相符合:当合金熔体所含 有的两种原子数量接近时,相分离过程主要受调幅 分解机制控制;两种原子数量差别越大,越接近形 核生长机制.除此以外,从原子轨迹可视化图形中 还可以看出,Fe<sub>50</sub>Cu<sub>50</sub>合金熔体比Fe<sub>75</sub>Cu<sub>25</sub>合金 熔体达到平衡所需的时间要短,表现出异种原子数 量越接近,原子扩散范围越小,完成相分离过程所 需要的时间越短.

#### 4.2 Fe<sub>50</sub>Cu<sub>50</sub>合金熔体配位数变化

为了进一步探讨相分离过程中微观结构参数 的变化,我们计算了熔体的偏配位数及总配位数随 时间的变化,如图3所示.从图中可以看出,原子总 配位数为13.8, 几乎不随时间发生变化. 而偏配位数的变化十分明显, 在0时刻到2ns时刻中, Cu原子周围的Cu原子数呈现递增趋势, 平衡时大约为9.3. 同样, Fe原子周围Fe原子的数量随时间延长也呈现上升趋势, 最终稳定在10左右. 与之相反, Fe原子周围的Cu原子数目则随着时间的变化呈下

降的趋势,最终下降到4.6 左右. 2 ns 后,合金熔体 中各原子之间的配位数近似稳定,系统达到平衡状态.最终同种原子的配位数比异种原子对之间的大 5 左右,表明同种原子对之间的相互作用明显高于 异类原子对.这也从微观层次上揭示了液-液相分 离特征.



图 2 Fe<sub>75</sub>Cu<sub>25</sub> 合金熔体在 1823 K下的原子轨迹 (a)—(j) 分别表示时刻 0, 0.1, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.9, 1, 2, 3 ns; 深色球是 Fe 原子, 浅色球是 Cu 原子



图 3 1823 K 温度下 Fe<sub>50</sub>Cu<sub>50</sub> 合金熔体中配位数分布 随时间的变化



图 4 (网刊彩色) 3000 ps 时刻 Fe<sub>50</sub>Cu<sub>50</sub> 合金熔体的 B-T 结构因子

#### 4.3 Fe<sub>50</sub>Cu<sub>50</sub>合金熔体相关长度变化

图 4 为 3 ns 时刻 Fe<sub>50</sub>Cu<sub>50</sub> 合金熔体的 B-T 结构因子,在整个 q范围内三种偏结构因子的变化趋势各不相同.而当 $q \rightarrow 0$  时,  $S_{CC}(q)$  的值突然增大,这说明 Fe<sub>50</sub>Cu<sub>50</sub> 合金液体具有相分离的趋势.为进一步研究其相分离过程,通过 B-T 结构因子我们计算了反映熔体相分离尺度的结构参数相关长度 $\xi$ ,其随时间的变化如图 5 所示.



图 5 Fe<sub>50</sub>Cu<sub>50</sub> 与 Fe<sub>75</sub>Cu<sub>25</sub> 合金熔体中相关长度与时 间的关系

从图5中可以看出,在相分离初期,Fe<sub>50</sub>Cu<sub>50</sub>合金熔体相关长度的变化十分明显,随时间延长

迅速增加,开始时相关长度增大的很快,大约2 ns 后体系达到平衡,相关长度数值不再发生变化. Fe<sub>75</sub>Cu<sub>25</sub>合金熔体相关长度随着时间的变化也表 现出同样的趋势,并在3 ns达到平衡,所需时间较 长.这表明异类原子数量越相近,该合金熔体相分 离平衡的速度越快.这个结论也从图1和图2中得 到验证.而通过比较两种成分的相关长度的大小可 知,Fe<sub>75</sub>Cu<sub>25</sub>合金熔体数值较小.这表明合金熔体 中异类原子的数量越接近,形成的网络状组织越明 显,同类原子相互关联的尺度越大.

#### 5 结 论

本文采用镶嵌原子势作用势,通过分子动力学 模拟从原子层次上揭示了液态 Fe50Cu50, Fe75Cu25 合金在1823 K温度下相分离过程及其结构的变化. 计算结果表明,这两种合金液均表现出了明显的 液-液相分离特征:当异类原子数量接近时,相分离 过程受调幅分解机制控制,最终合金液分层,形成 富Fe层和富Cu层;而当异类原子数量差别较大时, 相分离过程中调幅分解机制不明显,主要受形核生 长机制控制, 最终在富 Fe 基体下形成富 Cu 大液滴. 相分离过程可视化和相关长度的计算结果表明:相 分离的程度和完成时间与合金成分有直接联系,异 类原子数量越接近, 越容易发生相分离, 分离完成 时间也就越短. 配位数的变化也从原子尺度上揭 示了相分离特征:同类原子的配位数随时间逐渐递 增,而异类原子的配位数则递减,达到平衡后同类 原子的配位数明显高于异类原子.

#### 参考文献

- Li D, Robinson M B, Rathz T J, Williams G 1998 Mater. Lett. 36 152
- [2] Ojha S N, Chaitonuinfay K 1978 Trans. Indian Inst. Metals 31 208

- [3] Koch C C 1995 Mater. Trans. JIM 36 85
- [4] Ratke L, Diefenbach S 1995 Mater. Sci. Eng. R. 15 263
- [5] Schroenitz M, Dreizin E L 2003 J. Mater. Res. 18 1827
- [6] Islam F, Medraj M 2004 Proceedings of CSME Forum p921
- [7] Awe O E, Akinlade O, Hussain L A 2005 J. Alloys Compd. 387 256
- [8] Kuendig A 2004 Acta Mater. 52 2441
- [9] Sohn S W, Yook W, Kim W T, Kim D H 2012 Intermetallics 23 57
- [10] Cahn J W, Hilliard J E 1959 J. Chem. Phys. 31 539
- [11] Cahn J W, Hilliard J E 1959 J. Chem. Phys. 31 688
- [12] Siggia E D 1979 Phys. Rev. A 20 595
- [13] Aarts D G A L, Schmidt M, Lekkerkerker H N W 2004 Science 304 847
- [14] Gunton J D, Miguel M S, Sahni P S 1983 Phase Transitions and Critical Phenomena (London: Academic Press) p269
- [15] Bhat S, Tuninier R, Schurtenberger P 2006 J. Phys. Condens. Matter 18 L339
- [16] Bates F S, Wiltzius P 1989 J. Chem. Phys. 91 3258
- [17] Bailey A E, Poon W C K, Christianson R J, Schofied A B, Gasser U, Prasad V, Manley S, Segre P N, Cipelletti L, Meyer W V, Doherty Mp, Sankaran S, Jankovsky A L, Shiley W L, Bowen J P, Eggers J C, Kurta C, Lorik Jr T, Pusey P N, Weitz D A 2007 *Phys. Rev. Lett.* 99 205701
- [18] Tanaka H 1995 Phys. Rev. E **51** 1313
- [19] Ren Q, Wang N, Zhang L, Wang J Y, Zheng Y P, Yao W J 2012 Acta Phys. Sin. 61 196401 (in Chinese)[任群, 王楠, 张莉, 王建元, 郑亚萍, 姚文静 2012 物理学报 61 196401]
- [20] Fang T, Wang L, Peng C X, Qi Y 2012 J. Phys.: Condens. Matter 24 505103
- [21] Cao Z D, Georg P G 2005 Chin. Phys. Lett. 22 482
- [22] Wang C P, Shi R P, Liu J X, Wang Y, Kainuma R, Ishida K 2002 Science 297 990
- [23] http://www.ctcms.nist.gov/-cbecker/Cu.html
- [24] Bhatia A B, Thornton D E 1970 Phys. Rev. B 2 3004
- [25] Faber T E, Ziman J M 1965 *Phil. Mag.* **11** 153
- [26] Griesche A, Horbach J, Das S K 2007 Phys. Rev. B 75 174304
- [27] Binder K, Das S K, Hobrach J, Parlee N A D 2006 J.
  Chem. Phys. 125 024506

# Liquid-liquid phase segregation process of Fe<sub>50</sub>Cu<sub>50</sub> melt by molecular dynamics simulation<sup>\*</sup>

Qi Yu Qu Chang-Rong Wang Li<sup>†</sup> Fang Teng

(School of Mechanical and Electrical and Information Engineering, Shandong University at Weihai, Weihai 264209, China)
 (Received 12 September 2013; revised manuscript received 10 November 2013)

#### Abstract

Molecular dynamics simulation based on the newly developed embedded atom method has been performed to explore the microstructure of liquid  $Fe_{50}Cu_{50}$  alloy. The results show that coordination numbers (CNs) of Fe-Fe and Cu-Cu for  $Fe_{50}Cu_{50}$  melt gradually increase with relaxation time increasing, and they are 9.9 and 9.3 respectively as the liquid is in an equilibrium state; while the CN of heterogeneous atomic pairs Fe-Cu gradually decreases, and it is about 4.6. The correlation length (CL) extracted from Bhatia-Thornton (B-T) structure factor increases with relaxation time increasing. Both CN and CL indicate that the  $Fe_{50}Cu_{50}$  melt exhibits liquid-liquid (L-L) phase separation. The interconnected type of structure can be observed in the  $Fe_{50}Cu_{50}$  melt at the early stage, then the heterogeneous atomic pairs separate gradually with time going by, the Fe-rich and Cu-rich structure are formed, which shows the characteristics of spinodal decomposition. By comparison, the atom snapshot of  $Fe_{75}Cu_{25}$  melt is also visualized in the paper, and the finding indicates that the smaller number difference between Fe atom and Cu atom may lead to the stronger L-L phase separation, as a result of shorter time to reach stable layer-like structure. Our studies mentioned above characterize L-L phase separation of metallic liquid on the atomic scale.

**Keywords:**  $Fe_{50}Cu_{50}$  melt, liquid-liquid phase separation, spinodal decomposition, molecular dynamics simulation

PACS: 64.75.Op, 61.20.Ja, 61.25.Mv, 71.15.Pd

**DOI:** 10.7498/aps.63.046401

<sup>\*</sup> Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 51371108) and the Graduate Innovation Foundation of Shandong University at Weihai, China (Grant No. yjs12032).

 $<sup>\</sup>dagger$  Corresponding author. E-mail: wanglihxf@sdu.edu.cn